## 1.4 本章習題

- 1.請分別使用化學鍵結模型(chemical bond model)與能帶模型(energy band model)來解釋施體(donor)與受體(acceptor),並各舉一例。
- 2. 試區別本質半導體(intrinsic semiconductor)與外質半導體(extrinsic semiconductor);以及分辨本質費米能階(intrinsic Fermi level)E<sub>i</sub> 與費米能階(Fermi level)E<sub>e</sub>。
- 3. 何謂質量作用定律(mass-action law)?它適用在本質半導體還是外質半導體,還是都適用?
- **4.**何謂 n 型半導體與 p 型半導體。並請使用  $E_c$ , $E_v$ , $E_i$ ,與  $E_F$  來分別畫出其典型之能帶圖(energy band diagram)。
- 5. 在溫度為 0K時,於 Si 中摻雜磷(P)原子  $10^{16}cm^{-3}$ ,求電子與電洞的濃度? 並請畫出能帶圖(圖中標示須包括  $E_D$  或  $E_A$ )?
- 6. 在溫度為 300 K 時,於 Si 中摻雜硼(B)原子  $10^{16}$ cm<sup>-3</sup>,求電子與電洞的濃度?並請畫出能帶圖(圖中標示須包括  $E_D$ 或  $E_A$ )?
- 7. 在室溫完全游離的情況下,於半導體 Si 中掺雜濃度為  $N_A$  的 boron (注意, $N_A$  並不一定遠大於  $n_i$ ),則請以  $N_A$  和  $n_i$  來表示此半導體中電洞的濃度。
- 8. 上題中,若摻雜 boron 的量  $N_A$  遠大於  $n_i$ ,則請以  $N_A$  和  $n_i$  來表示此半導體中自由電子的濃度。
- 9. 在 300K下,若於 Si 中掺雜濃度為  $N_D$  的磷會使得 Fermi level 位於 Ec 下方 Eg/4之處。今若改使用摻雜硼,且使得 Fermi level 位於 Ec 下方 7Eg/8之處,則欲摻雜硼離子的濃度須等於多少?(請用  $N_D$ 表示,並假設  $E_i$  恰位於 Ec 與 Ev 之中央)
- 10.考慮在溫度為 300K 時的一個n型矽半導體,假設電子濃度在 0.01cm的距離中由  $1 \times 10^{14}$ cm<sup>-3</sup>之濃度作線性增加至  $5 \times 10^{15}$ cm<sup>-3</sup>。如果電子擴散係數  $D_n$  = 35cm<sup>2</sup>/sec,求擴散電流密度與擴散電流方向。
- 11.某個 n 型矽半導體在溫度為 300K 時之電子濃度可表示為: $n(x) = 10^{18} exp(-x/$